

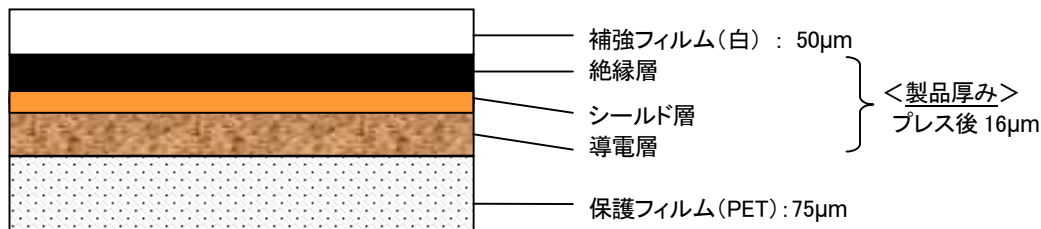
LIOELM TSS[®]500Z-S-2

【特徴】

本製品は、高速伝送用に設計されたシールドフィルムで、高屈曲性、鉛フリー半田耐熱性を有する FPC 用電磁波シールドフィルムで、伝送ロスを低減します。

高速通信が要求されるアンテナモジュールや USB モジュール用の FPC に最適な材料です。

【構成】



【物性】

製品名	TSS500Z-S-2
補強フィルム	50μm PET
シールド層	ウレタン樹脂ベース
保護フィルム	75μm PET
製品の厚み	16μm (プレス後)
シールド性	50dB 以上 (1GHz)
表面抵抗値	30mΩ/□ 以下
接着力 (PI) (N/10mm)	3N 以上
UL94 難燃クラス	VTM-0 *TSS/kapton50H/TSS

上表の値は実測値であり保証値ではございませんので、実用に際しては確認を行ってください。

<接着力測定条件>

- 構成 : Kapton200EN /(導電層側)TSS(絶縁層側)/Adhesive Sheet/Kapton200EN
- プレス工程 : Laminate 90°C → Press 170°Cx 2MPa x 30 min.
- 引張速度 : 50mm/min.
- 引張角度 : 90°

【使用方法 (クイックプレス)】

- 1) 導電層側の保護フィルムを剥離します。
- 2) FPC と貼り合わせします(仮貼り)。
- 3) 3分以上真空で補強フィルムをつけた絶縁層側からプレスします。
- 4) 補強フィルムを剥離します。
- 5) ポストキュアを行います。

トヨーケム株式会社 情報・通信材営業本部

〒104-8379 東京都中央区京橋 2-2-1

TEL 03-3272-0905 FAX 03-3272-0938 <https://www.artiencegroup.com>

【使用方法（プレスのみ）】

- 1) 導電層側の保護フィルムを剥離します。
- 2) FPC と貼り合わせします（仮貼り）。
- 3) 補強フィルムをつけた絶縁層側からプレスします。
- 4) 補強フィルムを剥離します。

【推奨プレス条件】

	プレス条件			ポストキュア	
	温度	圧力	時間	温度	時間
クイックプレス &ポストキュア	170±10°C	2～3MPa	3min.以上	160±10°C	1Hr.以上
プレスのみ	170±10°C	2～3MPa	60min.以上	—	—

【製品の保管について】

- 10°C /70%RH の保冷環境下で保管してください。
- 保冷保管環境から室温に戻してご使用ください。推奨時間は 7 時間です。
- 打ち抜き加工からプレス時間まで時間を要する場合は、保冷環境で保管してください。